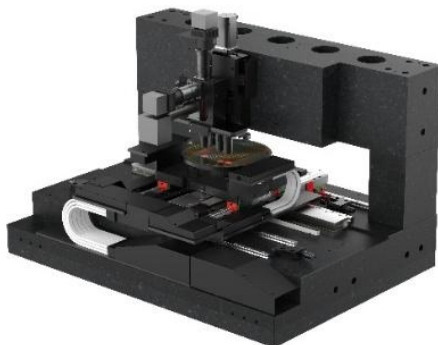


第2回 [関西]ネプコン ジャパンに初出展

【関西初】半導体製造後工程の進化を加速 ナノ精度位置決めステージ【N2】展示

世界トップクラスのシェアを誇る直動製品の他、モーションコントロールに関わる精密機器や産業用ロボットなど幅広い製品の開発、製造、提案、販売、メンテナンスを手掛ける精密部品・機器メーカーのハイウィン株式会社（本社：兵庫県神戸市西区、代表取締役：林育志）は、2026年5月13日から5月15日にインテックス大阪にて開催される、第2回[関西]ネプコン ジャパン（以下、関西ネプコン）に出展します。



関西ネプコンは、関西地域で唯一のエレクトロニクス開発・実装分野に特化した展示会です。これまで電子部品や実装技術に関する大規模展示会は東京開催が中心でしたが、当社としては関西エリアのお客様に、直接製品をご覧いただく機会を増やしたいと思い、第2回目の開催となるネプコン関西へ出展を決定いたしました。

当社は神戸に本社を構えショールームもありますが、関西での展示会を通して地域のお客様に幅広い製品群や豊富なラインアップをご覧いただき、今後もお客様の製品の付加価値向上と、次世代ものづくりを支えてまいります。

出展内容紹介と見どころ

本展示会ではステンレス鋼対応の「リニアガイドウェイ」や小型・静音タイプの「ボールねじ」に加え、±2nmの位置決め安定性と高速動作を両立する「N2 ナノ精度位置決めステージ」を関西の展示会で初めて展示します。

▼ステンレス製リニアガイドウェイ【Mシリーズ】

【炭素鋼製のスペックはそのままで、耐食性能を大幅に向上。半導体製造装置にも最適】



レール、ブロック、ボール、グリースニップル、ねじ、主要部品すべてにステンレス鋼を採用。耐食性に優れ、高湿度環境や腐食の進みやすい加工現場、さらには低～中真空環境など、さまざま過酷条件でもご使用いただけます。すべての機能・寸法が炭素鋼製と同等のため、そのまま置換え可能で安定した精度を維持でき、工作機械・食品・医療・半導体・自動化産業など、幅広い産業における信頼

本件に関するお問合せ先

ハイウィン株式会社 マーケティング企画課 e-mail:kikaku@hiwin.co.jp TEL:078-997-8827(代表)

性向上に貢献します。

▼超薄型 DD モーター搭載 精密位置決めステージ

【半導体・LED・FPD 産業向けに、コンポーネントにとどまらないサブシステムをご提案】



当社製の業界最薄クラスの「DD モーター/DMT シリーズ」とリニアモーターを組合わせた XYθステージは厚みも幅もコンパクト。部品点数も大幅に削減し、メンテナンス工数や組立て工数削減に貢献します。自動化機器、省人化機器、搬送機器の省スペース化や低重心化による装置剛性向上に寄与するほか、ウエハパッケージング装置など、半導体製造工程にもご活用いただけます。

▼【関西初展示】ナノ精度位置決めステージ【N2】

【半導体製造後工程の進化を加速する精密ステージ。短納期 & 高コスパで開発納期短縮にも貢献！】



半導体検査装置や製造装置向けに開発された高精度リニアモーターステージです。

±2nm の位置決め安定性と 100 mm/s 動作時でも ±0.1% の速度リップルにより、微細化が進む半導体工程において極めて高い検査・加工精度を実現します。低床構造と高剛性設計により装置組込み時の安定性と省スペース化を両立し、検査・露光・パッケージングなど幅広い工程で性能を発揮します。

YouTube で動画公開中【[新ラインアップ](#)】[ナノ精度位置決めステージ【PLP 検査/ウエハ検査装置に】](#)】

▼開催概要

展示会名：第2回 [関西] ネプコン ジャパン -エレクトロニクス開発・実装展-

日時：2026年5月13日(水)～15日(金) 10:00～17:00

会場：インテックス大阪

小間番号：K35-30 (第6展示館)

主催：RX Japan 合同会社

概要：電子機器・半導体・パワーデバイスの設計開発の課題解決、生産性向上、コストダウンを実現するための製品・技術などが展示されます。

参加：無料 ※事前来場登録制

公式 HP：<https://www.nepconjapan.jp/osaka/ja-jp.html>

【ハイウィン株式会社について】

HIWIN (ハイウィン) は台湾、台中に本社 (資本金約 160 億円、従業員約 6,400 名) を置き、日本の他に世界 12 か国に拠点を持つグローバル企業です。社名でありブランド名である HIWIN は「With us, you are a HI-tech WINner. (当社とともに、ハイテク分野の勝者になっていただきたい)」という思いが込められています。ボールねじ、リニアガイドウェイなどの直動機器を主力製品に、工作機械、自動車、

本件に関するお問合せ先

ハイウィン株式会社 マーケティング企画課 e-mail:kikaku@hiwin.co.jp TEL:078-997-8827 (代表)

半導体および半導体製造装置の世界有数メーカーへ納入実績を積み上げ、優良パートナー企業へと躍進しています。(ISO9001, ISO14001, ISO45001 認証取得) 1999年に設立された日本法人、ハイウィン株式会社は本社を兵庫県神戸市西区に構え、日本全国10か所に営業拠点を配置しています。豊富な製品バリエーションと世界最高クラスの生産キャパシティで、直動製品の安定供給だけでなく、あらゆる自動化ニーズに対応し次世代ものづくりを支えています。

本件に関するお問合せ先

ハイウィン株式会社 マーケティング企画課 e-mail:kikaku@hiwin.co.jp TEL:078-997-8827(代表)